

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005年2月3日 (03.02.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/010077 A1

(51) 国際特許分類: C08G 77/14, 77/20, G03F 7/075

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/010853

(22) 国際出願日: 2004年7月29日 (29.07.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2003-203411 2003年7月29日 (29.07.2003) JP
特願2003-203412 2003年7月29日 (29.07.2003) JP

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 東亞合成株式会社 (TOAGOSEI CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1058419 東京都港区西新橋1丁目14番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 田内 久仁和 (TAUCHI, Kunikazu) [JP/JP]; 〒4550027 愛知県名古屋市港区船見町1番地の1 東亞合成株式会社 新製品開発研究所内 Aichi (JP). 鈴木 浩 (SUZUKI, Hiroshi) [JP/JP]; 〒4550027 愛知県名古屋市港区船見町1番地の1 東亞合成株式会社 新製品開発研究所内 Aichi (JP).

(74) 代理人: 小島 清路 (KOJIMA, Seiji); 〒4560031 愛知県名古屋市熱田区神宮三丁目7番26号 热田大同生命ビル2階 Aichi (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

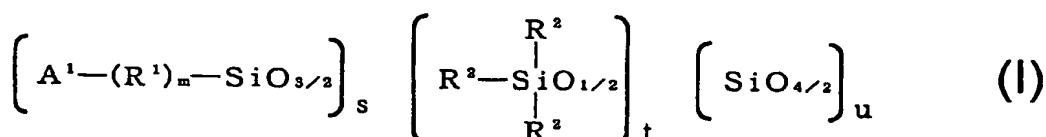
(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 國際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドスノート」を参照。

(54) Title: SILICON-CONTAINING POLYMER, PROCESS FOR PRODUCING THE SAME, HEAT-RESISTANT RESIN COMPOSITION, AND HEAT-RESISTANT FILM

(54) 発明の名称: 硅素含有高分子化合物及びその製造方法並びに耐熱性樹脂組成物及び耐熱性皮膜



(57) Abstract: An alkali-soluble silicon-containing polymer which is represented by the following formula and has a weight-average molecular weight of 500 to 500,000. (I) In the formula, A¹ is phenyl having hydroxy or alkoxy; R¹ is C₁₋₄ alkylene; m is 0 or 1; R² is C₁₋₄ alkyl; and s and u each is a positive number and t is 0 or a positive number, provided that 0 ≤ t/(s+u) ≤ 1 and 0 < u/s ≤ 5.

WO 2005/010077 A1

/統葉有/